

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年1月14日(14.01.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/006208 A1

(51) 国際特許分類:
B65D 65/40 (2006.01) *B65D 85/86* (2006.01)
B32B 27/08 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/026205

(22) 国際出願日: 2020年7月3日(03.07.2020)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2019-128925 2019年7月11日(11.07.2019) JP

(71) 出願人: デンカ株式会社 (**DENKA COMPANY LIMITED**) [JP/JP]; 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 阿津坂 高範 (**ATSUSAKA, Takanori**); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 丹羽沙織 (**NIWA, Saori**); 〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP). 齊藤 岳史 (**SAITOH, Takeshi**);

〒1038338 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 デンカ株式会社内 Tokyo (JP).

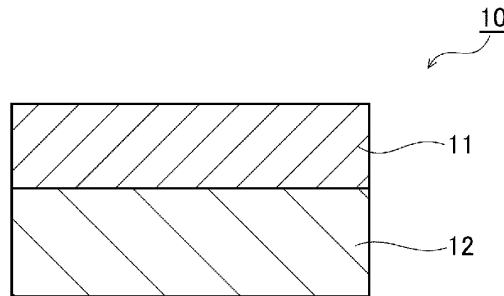
(74) 代理人: 園田・小林特許業務法人 (**SONODA & KOBAYASHI INTELLECTUAL PROPERTY LAW**); 〒1630434 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号 新宿三井ビル34階 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,

(54) **Title:** COVER FILM AND ELECTRONIC COMPONENT PACKAGE USING SAME

(54) 発明の名称: カバーフィルム及びそれを用いた電子部品包装体



(57) **Abstract:** The present invention is a cover film having at least a substrate layer and a sealant resin layer. The sealant resin layer is formed such as to be in contact with one surface of the substrate layer, or is formed on an intermediate resin layer that is in contact with one surface of the substrate layer. The intermediate resin layer in contact with the substrate layer or the sealant resin layer in contact with the substrate layer contains an epoxidized fatty acid or a derivative thereof. The cover film has excellent interlayer adhesiveness without using an anchor coating agent.

(57) 要約: 本発明は、基材層とシーラント樹脂層とを少なくとも有し、シーラント樹脂層が、基材層の一方の面に接するように形成され、又は、基材層の一方の面に接する中間樹脂層上に形成され、基材層に接する中間樹脂層又は基材層に接するシーラント樹脂層が、エポキシ化脂肪酸又はその誘導体を含有する、カバーフィルムであり、アンカーコート剤を用いずとも層間接着性に優れる。

[続葉有]

WO 2021/006208 A1

MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）